

PERFAG 3D (Deutsch/Englisch)



Spezifikation für Mehrlagen-Leiterplatten, Specification for Multilayer PCBs, 232 Seiten, Format: DIN A4

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

69,16 €

Preis inkl. MwSt.

69,16 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

PERFAG 3D gilt für die Spezifikation neuer Multilayer für den Leiterplattenhersteller. Die Spezifikation ist das Ergebnis einer freiwilligen Zusammenarbeit zwischen der PERFAG-Gesellschaft und den ihr angeschlossenen Leiterplattenproduzenten. Der Inhalt der Spezifikation ist eine Empfehlung, die freiwillig befolgt werden kann. Die PERFAG-Gesellschaft haftet auch nicht für Folgen, die aus Anwendung dieser Spezifikation entstehen.

Die Hauptkapitel PERFAG 3D im Überblick:

1. Basismaterial
2. Leiterbild
3. Durchmetallisierte Löcher
4. Nicht-metallisierte Bohrungen
5. Vergoldung von Kontakten
6. Lötstoppmasken
7. Decklagen
8. Komponentendruck
9. Kohleleitpastendruck (Carbondruck)
10. Abziehmasken
11. Oberflächenschutz
12. Oberflächenreinheit
13. Löten
14. Mechanische Bearbeitung
15. Abkürzungen

16. Vokabular

The main chapters PERFAG 4B at a glance:

1. Base Material
2. PCB Pattern
3. Plated-Through Holes
4. Nonplated-Through Holes
5. Gold for Contacts
6. Solder Masks
7. Coverlays
8. Component Notation
9. Carbon Ink Printing
10. Peelable Masks
11. Surface Protection
12. Cleanliness of Surface
13. Soldering
14. Machining
15. Abbreviations
16. Vocabulary